

证券代码：688362

证券简称：甬矽电子

甬矽电子（宁波）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-013

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>其他（<u>投资者开放日</u>）</div>
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2025 年 12 月
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长、总经理王顺波先生 董事、副总经理徐玉鹏先生 董事会秘书、副总经理李大林先生 研发总监钟磊先生
投资者关系活动主要内容介绍	<div>1、公司整体发展经营情况介绍？</div> <div>甬矽电子成立于 2017 年 11 月，从成立之初就聚焦集成电路中高端及先进晶圆级封装测试服务，终端包含消费类电子、物联网、工业/汽车电子及 AI 高性能计算领域等。公司总部位于浙江省宁波市余姚市，在上海、深圳、中国台湾等地设销售办公室，拥有两个生产基地，一期占地 126 亩，投资 45 亿，专注成熟封装产品；二期占地 300 亩，预计总投资 110 亿，聚焦先进封装产品；未来拟于马来西亚建设三期基地以更好服务海外大客户。公司从 2018 年 6 月实现量产，当年实现营业收入超过 3000 万；2019 年全年出货量超过 9 亿颗并通过车规认证。2022 年于科创板上市；2023 年二期工厂启动；2024 年营收增长率超过 50%。从公司成立至今，出货量及营业收入一直保持增长状态。</div> <div>2、盈利能力情况？</div>

	<p>2019 年至 2021 年,随着公司高端封装产品系统级封装产品 (SiP) 收入规模及占比、毛利率的提高, QFN 等产品销售单价及毛利率的提高, 公司毛利率及净利润逐年增长。2022 年至 2023 年, 受宏观经济增速放缓、国际地缘政治冲突和行业周期性波动等多重因素影响, 以消费电子为代表的终端市场整体需求疲软, 半导体行业需求出现较大波动, 整体出现周期性下行。下游客户处于去库存阶段, 并且 2023 年二期工厂启动, 相应固定资产折旧进入财务报表中, 导致该阶段毛利率处于较低水平。2023 年后迎来行业周期拐点, 随着全球终端消费市场出现回暖, 产业链去库存周期基本结束, 叠加 AI 应用场景不断涌现, 集成电路行业整体景气度回升明显在公司层面, 得益于海外大客户突破并且在 2025 年持续放量, 以及原有核心客户群高速成长, 规模效应逐渐体现, 整体毛利率回升。</p> <p>3、资本开支及折旧情况?</p> <p>集成电路封装和测试行业是较为典型的资本密集型行业, 收入规模同固定资产投资规模直接相关。从成立至今, 公司主营业务持续快速发展, 固定资产投资规模及折旧金额也随之逐年增加, 公司 2025 年资本开支规模在 25 亿元以内, 较 2024 年保持稳定, 主要投向包括现有产品线产能扩张、晶圆级封装及 2.5D、FC-BGA 等先进封装领域。随着固定资产的继续投入, 2025 年全年折旧的绝对金额预计相比 2024 年仍会上涨。固定资产中约 90%为专用设备, 投入专用设备金额大且折旧年限较短, 折旧年限集中在 5 至 8 年内, 导致前期折旧金额较大。受该因素影响, 公司近年来毛利率和 EBITDA Ratio、净利润和 EBITDA 之间都存在较大差异。未来随着原有投资设备折旧期陆续到期, 折旧压力缓解, 利润空间有望逐步释</p>
--	---

	<p>放, 对整体盈利能力产生积极影响, 毛利率将逐渐趋近于 EBITDA Ratio, 公司理想的稳态毛利率在 25%-30% 左右。</p> <p>4、产品下游应用领域结构情况?</p> <p>AIoT 营收占比接近 70%, 目前 AIoT 领域处于“创新驱动”周期, AI 驱动下新应用场景渗透率提升, 下游需求预计将会持续增长; PA 营收占比约为 10%, 后续重心以 PAMiF 及 PAMiD 模组类产品为主; 安防营收占比约为 10%, 整体增速平稳; 运算和车规产品营收合计占比 10% 左右, 未来随着国内车规设计公司的发展以及海外车规大厂本土化布局战略的推进和 AI 发展对运算类芯片的需求, 预计运算和车规领域的增速较快, 营收占比将会持续提升。</p> <p>5、目前先进封装领域行业及公司概况?</p> <p>AI 大模型 (训练/推理) 及 HPC 云端 AI 需求推动芯片向先进制程 (2.5D/3D) 快速迭代; 智驾、AI 眼镜等端侧 AI 新应用场景拓展促使芯片向高算力和低功耗异构集成演进; AI 发展从结构和需求端驱动芯片加速迭代; 智能驾驶、AI 机器人 (含工业机器人), 从芯片数量、精度、智能化三个维度驱动传感器芯片发展, 传感器向与 AI 深度融合演进 (感知+决策一体), 带来高阶传感器芯片的需求和封装技术发展。</p> <p>公司坚定践行技术创新战略, 以前瞻性布局切入先进封装领域, 基于自有的 Chiplet 技术推出了 FH-BSAP (Forehope-Brick-Style Advanced Package) 积木式先进封装技术平台。涵盖 RWLP 系列 (晶圆级重构封装, Fan-out 扇出封装)、HCOS 系列 (2.5D 晶圆级/基板上异构封装)、Vertical 系列 (晶圆级垂直芯片堆栈封装) 等, 精准适配客户多元化先进封装技术需求。</p> <p>6、期间费用情况?</p>
--	--

	<p>销售费用率方面，目前基本保持在 1%左右，销售费用控制效果较好；管理费用率方面，2023 年达到峰值 9.96%，主要是由于二期工厂启动需要提前储备人力资源，当年员工数量同比增长率远大于营收增长率。随着规模效应逐渐显现，2024 年及 2025 年管理费用率均保持下降趋势；财务费用率方面，公司成立时间较短，且处于高速发展阶段，依靠自有资金积累无法满足扩产所需的设备采购、厂房建设需求，公司主要通过银行借款进行扩产。未来随着盈利逐步改善、营收规模扩大以及融资渠道拓展，财务费用率将会呈现稳步下降状态。研发费用率方面，公司专注于中高端先进封装，围绕先进封装领域，研发投入持续提升，研发费用率将会维持在 6%左右的水平。</p> <p>7、海外客户拓展情况？</p> <p>目前海外有两家中国台湾地区头部设计公司已经进入公司前五大客户，并积极拓展包含欧美地区在内的其他海外头部设计企业。整体而言，随着公司营收规模不断扩大和服务能力的持续提升，公司与现有海外客户的合作将进一步深化，并将持续在新的海外客户取得突破，公司预期未来海外客户营收占比会进一步提升。</p> <p>8、海外工厂进展情况？</p> <p>新加坡子公司和马来西亚子公司已成立完成，目前海外工厂建设工作正在稳步推进中。</p> <p>9、公司对于未来经营发展的展望？</p> <p>经营业绩方面，从 2018 年首年营收 0.39 亿到 2024 年实现营业收入 36 亿元，公司用七年时间实现营业收入近百倍增长。未来随着二期项目完全落成达产，大规模投资进入尾声，折旧拐点出现，同时伴随规模效应的持续体现，远期业绩较为可观；客户结构方面，公司成立之初从</p>
--	---

	<p>数字货币芯片切入市场，到进入主流 PA 设计公司供应链，再到深化 AIoT 大客户合作以及实现海外头部设计客户突破，目前已经形成了以各细分领域的龙头设计公司以及台系头部设计公司为主的稳定客户群，未来大客户以及海外营收占比会持续提升，客户集中度将进一步提高；先进封装方面，公司从成立之初即聚焦先进封装领域，全部产品均为 QFN、LGA、BGA、FlipChip、Bumping、WLCSP 等中高端先进封装形式，努力将公司打造成为“Bumping+CP+FC+FT”的一站式封测基地。2024 年底公司 2.5D 封装产线通线，未来随着生成式 AI、高算力芯片需求提升以及端侧 AI 应用场景不断拓展，公司先进封装产品占比将不断提高。</p> <p>10、公司在先进封装领域的技术储备及良率情况？</p> <p>技术储备方面，公司今年截至目前新增专利 160 余项，其中先进封装技术相关专利超过 100 项；良率方面，公司目前与客户送样产品良率表现较好。</p> <p>11、公司 2025Q4 以及 2026Q1 业绩展望？</p> <p>今年四季度的营业收入预计将会保持增长趋势；明年一季度客户需求 Forecast 是比较旺盛的。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 12 月 22 日

注：公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，如涉及公司战略规划等意向性目标，不能视为公司或管理层对公司业绩的保证或承诺，敬请广大投资者注意投资风险。